

# 基板設計・実装受託ゾーン

- 会 期： 2017年1月18日 [水] ~ 20日 [金]
- 会 場： 東京ビッグサイト
- 主 催： リード エグジビション ジャパン株式会社
- 併 催： 第46回 インターネブコン ジャパン 第34回 エレクトロテスト ジャパン  
第18回 半導体パッケージング技術展 第18回 電子部品・材料 EXPO  
第7回 微細加工 EXPO
- 出展料金： ￥934,000 / 小間 (6m×2.7m) ■ 角小間料金： ￥20,000  
コンパクトタイプ [3.0m×2.7m] は小間料金が半額となります。

## 本展は商談のための展示会です



### 出展スペース料金に含まれる主なサービス

- 出展スペースの提供 (ただし、ディスプレイなどの料金は含まれません。)
  - 展示会招待券の無料提供
  - VIP 特別招待制度のご利用
  - 業界関係誌紙など媒体へのプレスリリースによる貴社出展情報事前告知
  - 本展と貴社のホームページリンクサービス
- ※この他にも、出展効果を高めるための様々なサービスをご用意しております。